

## 2020年度中期経営計画 “DAIHEN Value 2020”

### 1. 前中期経営計画の総括

- ・当社は2012年度から6年間に亘り、お客様に喜んでいただき、世の中のお役に立つダイヘン独自の製品価値の創出(「ならでは開発」)を最重点とする“DAIHEN Value 2014及び同2017”に取り組んできた。
- ・開発面では、半導体の微細化加工で必要とされる高速整合機能を搭載した高周波電源システムや圧倒的な溶接品質で好評の「シンクロフィード溶接システム」のマルチマテリアル対応を進める他、独自のアルゴリズムで中央監視装置なしでV P Pを構築する「シナジーリンク」やAGV・EV向けワイヤレス給電システムなど、事業領域の拡大につながる新製品を多数開発した。
- ・また、開発強化に必要な資金を内部から生み出す目的で取り組んだ「ロスカット活動」では、コストダウンの取り組みを進めるだけでなく、自社ロボットを活用した生産自動化や間接業務のプロセス可視化とその分析によるムダ排除・情報システム化等を推進することで、単純作業時間を大幅削減した。
- ・「ならでは開発」、「ロスカット活動」の成果により売上高1.6倍増に増員なしで対応することで営業利益は2.7倍(2011年度比較)となり、過去最高益を更新して100億円に到達したが、中期経営計画の数値目標には未達となった。

	2011年度 実績 ①	2017年度		増減 ②/①比
		中計目標	実績 ②	
売上高	929億円	1,500億円	1,494億円	1.6倍
営業利益	37億円	—	100億円	2.7倍
営業利益率	4.0%	8%	6.7%	+2.7ポイント
ROE	4.5%	10%	9.3%	+4.8ポイント
社員	3,878人	—	3,861人	増加なし

### 2. 2020年度中期経営計画の基本的な考え方

- ・新中期経営計画(2018～2020年度)は「DAIHEN Value計画」の総仕上げとして、変圧器や溶接機といった既存の製品群の枠組みを超え、未来志向で発展性のある新ドメイン<sup>※</sup>での「ならでは開発」を推進すると同時に単品ビジネスからシステム志向のビジネスへの転換を図り、新たな顧客価値を創出し続ける「開発型の企業」としての体質を確立させる。 ※2頁3項参照
- ・「ロスカット活動」では、新たな製品設計思想に基づく生産自動化の追求とRPA(Robotic Process Automation)を活用した間接業務の自動化推進により、単純作業の撲滅を目指す。これらの取り組みの成果を更に拡大させるため、グループワイドで拠点間の役割分担も見直しコスト最適化を実現する。
- ・お客様に製品価値を認めていただき安心してご利用いただくため、ビフォアからアフターまで全てのプロセスに亘る独自の“D-サービス”の確立を目指し、営業・サービス一体で「セールスエンジニアリング力の強化」に取り組む。
- ・ステークホルダーへのリターン目標については、これまで曖昧であった「地域社会」に対する目標も明示して、“みんな<sup>※</sup>の幸せ(1985年小林啓次郎 元社長)同時達成”のシナリオを確立させることにより、社員のやり甲斐や目標達成への責任感を高める。

※お客様、社員と家族、株主、資材取引先、地域社会

■基本方針

- ①新ドメインでのならでは製品開発推進とシステム志向のビジネス展開
- ②グループワイドでのコスト最適化
- ③セールスエンジニアリング力の強化

■基本目標

	2020年度目標	(2017年度実績)
◇売上高	1,800億円以上	(1,494億円)
◇営業利益率	8%以上	(6.7%)
◇ROE	10%以上	(9.3%)
◇開発費率	5%以上	(4.9%)
◇配当性向(3年平均利益)	30%	(27.9%)



3. 基本方針の補足<新ドメインと開発の方向性>

- A. 「スマート・エネルギー・マネジメント分野」
  - ・スマートコミュニティ・再生可能エネルギー・蓄電池など多様化する分散化電源を制御・管理するシステムや機器を開発・提供するとともに、多様化する電力系統管理の高度化や電気自動車などの電力の新たな用途に資する技術を開発する。
- B. 「スムーズ・ファクトリー・オートメーション分野」
  - ・溶接ロボット・クリーン搬送ロボットで培った精度が高く機敏な動作特性を活かした当社独自のロボットを開発するとともに、当社が保有する独自技術を活用した各種センサや監視制御ソフト・周辺機器を組み合わせたフレキシブルで導入しやすいシステムを提供することで、工場全体の淀みない自動化を実現する。
- C. 「マテリアル・ファイン・プロセッシング分野」
  - ・プラズマ・レーザ・超音波・摩擦熱等のエネルギー源を高精度で制御することにより、金属・半導体・絶縁材料・樹脂材料などの精密な接合・切断・成膜・表面処理・造形など、モノづくりの技術革新に必要な新プロセスを提供する。

以 上